

### 1.5.3 SEMITOP

前面已经提到过的 SEMITOP 系列包含了三种外壳形式 (见图 1.57)。

像 SKiiPACK 和 MiniSKiiP 一样, SEMITOP 也属于不带底板的封装形式。通过一个特殊结构的塑料外壳, 整块的 DCB 被直接压在散热器上。

模块和散热器之间的连接是通过一个或者两个紧固螺栓来实现的。与 MiniSKiiP 有所不同, SEMITOP 与印刷线路板之间的连接是由两排可焊接的插脚式端子构成的。

在一个如此这般小的模块里最多可以集成 12 个功率元件。因此, SEMITOP 特别适合空间紧凑的应用。另外, 由于印刷线路板上介于焊接端子之间的面积可以不受限制地被应用, 所以在这一点上 SEMITOP 优于类似技术的 MiniSKiiP。